

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(记录表编号：2026-006)

投资者关系 活动类别	☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 一对一沟通 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 其他
时间	2026 年 10 月 26 日
地点/方式	线上会议
参与单位或人 员（排名不分 先后）	邦客资产、宝盈基金、碧云资本、长江资管、长青藤资产、创金合信基金、大成基金、大箐资产、德汇集团、第一上海证券、东方财富证券、东方证券、方正富邦基金、富安达基金、富国基金、高竹基金、格传基金、工银安盛、广发证券、国都证券、国海证券、国华兴益保险、国金证券、国联民生证券、国盛证券、国信证券、海富通基金、瀚伦基金、浩成资管、和谐健康、泓德基金、泓铭资本、华夏久盈、华创证券、华富基金、华福证券、华泰柏瑞基金、华泰证券、华西基金、华西银峰、华兴证券、华源证券、嘉实基金、嘉信天时、金蟾蜍投资、聚力财富、君和资本、凯丰投资、宽源基金、理成资产、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、铭深资产、宁涌富、诺安基金、磐泽资产、秋桐资产、筌笠资产、锐方私募、山证资管、上海证券、熵简基金、上汽金控、盛宇股权、神农投资、申万宏源证券、申万菱信基金、申万资管、时弈基金、十溢投资、数法基金、太平洋证券、太平资产、天风证券、天弘基金、同犇投资、UBS Securities、UG Investment Advisers、西部利得基金、相聚资本、星石投资、星元投资、玄卜投资、阳光天泓、阳光资产、阳合基金、野村国际、中国银河证券、盈赢私募、友邦人寿、远望角投资、驭秉投资、云禧私募、昱阳私募、招商基金、招商证券、招银国际、中航基金、中欧基金、中泰证券、中信保诚基金、中信证券、中银国际证券、中银基金

上市公司 接待人员	财务总监：孙君磊先生 董事会秘书：黄恬先生
投资者关系 活动主要内容	一、经营情况简介 2026 年前三季度，公司扎实推进各项经营部署，实现营业收入 152.33 亿元，同比增长 37.45%；归母净利润 16.16 亿元，同比增长 70.42%；扣非归母净利润 15.07 亿，同比增长 94.38%。汇兑损失对前三季度利润的负向影响明显，原材料价格上涨也对 PCB 行业企业盈利能力的影响深远。不过，受益于高速通信与 AI 数据基础设施领域的高性能 PCB 量产出货提速，叠加产品结构优化、作为行业头部企业的供应链保供优势、内部降本增效等多措并举，公司在 2026 年第三季度迎来业绩爆发，实现营业收入 66.21 亿元，同比增长 66.06%、环比增长 40.30%；归母净利润 10.14 亿元，同比增长 239.67%、环比增长 174.89%；扣非归母净利润 10.42 亿元，同比增长 337.47%、环比增长 227.07%。 报告期内，公司纵深推进“1+1+N”的业务布局。截至报告期末，支柱型业务汽车 PCB 盈利能力明显修复，订单结构持续优化；2026 年 1-3 季度，通信与数据基础设施业务收入占比已超过两成，其中 AI 服务器、高速光模块等细分赛道的收入增长明显，在手订单饱满。 公司在 AI 算力领域的技术储备、产能布局和客户基础已经形成强有力的支撑。AI 服务器与数据中心领域，报告期内，公司为全球 AI 计算基础设施领先企业客户批量供应高性能 PCB，客户当代产品已陆续进入量产交付阶段，订单快速增长。高速光模块领域，公司已在珠海金湾基地建成 5 条 mSAP 产线，其中 4 条已大批量生产、第 5 条正在调试，设备配置均为行业顶尖水平，能够快速响应未来产品的放量需求。 从行业层面看，AI 算力需求仍处于持续扩张周期，数据中心互联架构升级、AI 服务器平台迭代以及高速光模块速率提升，共同推动高端 PCB 需求保持较快增长，行业中长期成长逻辑清晰。我们在一线能真切感受到客户项目快速推进的节奏和需求释放的速度，我们对 AI 算力基础设施市场的长期发展充满信心。

二级市场短期有波动，但产业趋势和公司经营成果是实实在在的。在 AI 算力需求持续释放、汽车电子智能化加速演进的结构性机遇面前，公司已完成了从传统 PCB 制造商向高端算力硬件高性能 PCB 核心供应商的战略跃升，将继续坚守长期主义，聚焦高端高价值赛道，公司有信心把产品做好、把交付做好，用经营结果说话，回报全球股东。感谢大家一直以来的信任和陪伴。

二、投资者问答

问：公司目前的在建产能情况如何？

答：结合客户产品迭代及上量节奏，公司正聚焦于高阶 HDI、HLC、SLP 等高端产品加大产能投资和建设。成熟工厂中，珠海 HLC 工厂目前正大批量生产适用于 AI 算力领域的高多层 PCB，产能利用率保持高位；SLP 工厂目前已具备 5 条 mSAP 产线，其中 4 条已大批量生产，第 5 条线正在调试，同时具备批量的厚板高阶 HDI 产能，目前正为算力客户批量生产高阶 HDI。建设中的工厂有珠海的高阶 HDI 工厂、UHC 工厂，计划分别在 2026 年四季度和 2027 年一季度批量投产。泰国工厂已经投产，具备 AI 算力高多层板和高阶 HDI 产品批量能力，目前正在推进客户验证工作。

问：公司是否担心行业内 SLP 产能过剩？公司新增产能如何消纳？

答：公司规划产能建设主要基于行业技术发展趋势的判断，以及深入洞察客户未来产品的技术迭代路径。行业目前存在高端产品产能严重不足的情况，特别是 SLP 产能严重不足。从客户反馈情况来看，SLP 产品需求旺盛，公司新增产能能够得到消化。

问：是否有看到 AI 领域的订单需求放缓或推迟？

答：目前 AI 算力领域客户项目推进节奏依然较快，高端产品交付安排非常紧张。与此同时，AI 算力领域产品迭代升级带来的工艺难度明显增加，对 PCB 板厂的工艺技术能力、精细化管控能力、产品一次良率提出较高的要求，高端产能供给相对有限。整体看，需求端保持旺盛，供给端受产品升级和产能爬坡节奏约束，AI 算力领域的高性能 PCB 供应依然偏紧，公司正全力推进产能释放与保障交付。

问：公司目前的订单能见度情况？

	答：公司目前在手订单充足，汽车、工业控制等领域的订单能见度较此前更高，AI 算力领域高性能产品的订单能见度则更高，部分通信与数据基础设施领域客户提前给出了未来较长一段时间的出货预期。我们当前的重点工作是保质保量交付及推动新产能的投放。 问：原材料价格还在上涨，是否会带来公司利润承压？ 答：AI 算力基础设施建设的加速推进，同时也带动了 PCB 上游的覆铜板、半固化片及铜箔等核心原材料需求的集中释放，原材料市场供应趋紧，价格持续上行，短期内这一格局预计尚难根本改善。面对上游原材料价格持续上行带来的成本压力，PCB 企业向下游传导价格是行业维持正常运转的被动应对，成本压力的逐级传导有助于产业链上下游共同应对结构性变化。 覆铜板、半固化片等供给持续趋紧对 PCB 行业的稳定交付带来重大考验，这也是非常关键的。公司始终坚持以客户为中心，密切跟踪上游材料供应走势，及时动态调整材料库存水位，通过与供应合作伙伴锁定产能、提前备货等措施，全力保障原材料稳定供应，有力保障客户订单的及时交付与品质可靠，在行业波动中进一步巩固了市场口碑，赢得了更多客户的信赖。 问：2026 年三季度公司的盈利能力修复明显，是否具有持续性？如何展望未来的盈利能力情况？ 答：关于未来盈利能力的展望，公司总体保持审慎乐观。短期来看，随着 AI 相关高性能 PCB 产品逐步进入规模化出货阶段，产能利用率提升有助于摊薄固定成本；同时，高性能新产品在量产爬坡过程中良率逐步提升，也会对盈利能力形成正向支撑。长期来看，公司持续推动高附加值产品占比提升，叠加技术升级、精益生产和供应链协同等多措并举，有望带动整体盈利能力不断改善。 注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件	无
记录时间	2026 年 10 月 27 日整理